

Mini LED定制化含氧量回焊炉 HELLER回流焊苏州仁恩一级代理商

产品名称	Mini LED定制化含氧量回焊炉 HELLER回流焊苏州仁恩一级代理商
公司名称	苏州仁恩机电科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:HELLER 型号:1911MK5 产地:焊接
公司地址	吴中区胥口镇香山工坊9幢326室
联系电话	13372123118

产品详情

Mini LED定制化含氧量回焊炉 HELLER回焊炉设备

HellerIndustries是回流焊技术的先驱，成立于1960年，在二十世纪80年代制造完成HELLER台全对流式回流炉。HELLER回流焊已应用于集成电路封装,IGBT,Mini-LED,汽车,医疗,3C,航天,电力等电子工业应用行业。

HELLER真空回流焊主要特点：

多温区设计，更多温控点，满足不同温度工艺要求；2.的真空效果：有效消除空洞，总空洞面积可控制在1%以下；3.更高的生产效率：高效的生产能力，平均生产节拍在30-60秒；4.高效无油真空泵机组，可实现短降压时间；5.高效助焊剂回收系统，预防助焊剂残留；6.通过再真空腔体内安装加热丝，小化锡膏液态时间；

Mini - LED采用LED芯片尺寸为微米等级，每张Mini - LED线路板上通常会有数千个芯片，上万个焊点，以连接RGB三色芯片。如此巨量的焊点，给芯片的封装焊接带来了很大的难度。我们一起来了解一下焊接工艺。

相比传统的回流焊焊接工艺，Mini - - LED对工艺的要求达到了，据统计，焊接不良有40%以上是因为印刷工艺引起的，40%是由焊接引起的。其它20%和锡膏、基板材料有很大关系。对于Mini - LED的可靠焊接，对设备回流焊、焊接工艺、材料（锡膏）都提出了更高的要求，三者缺一不可。

设备 - 真空回流焊：

Mini - LED的焊盘更小、锡膏量更少、芯片更小，对焊接设备的要求、温度均匀度等工艺参数提出了更高的要求。目前焊接出现的问题包括：

- 1、芯片位移：芯片焊接之后有移动，需要减少裸芯片焊接后的移动。
- 2、芯片旋转：因为Mini - LED芯片本身间距只有0.8mm、0.6mm、0.4mm甚至更小，那么在焊接过程中，芯片本身在气氛环境下容易旋转，影响不良。
- 3、空洞率高：目前氮气回流焊焊接之后，采用低空洞率锡膏，焊接后空洞率也就控制到10%左右。普通的锡膏，焊接后空洞率可能达到15%以上。空洞率太高，长期使用因为导热效果或可靠性问题可能会导致产品不良。
- 4、虚焊：在选择回流焊的时候，氧气含量是个很重要的指标，如果氧含量不能控制到100ppm以内，甚至更低，有可能导致产品的虚焊。同时温度均匀度不达标也是一个很重要的因素。整个炉腔内的温度均匀度如果达不到2度以内，就会导致部分芯片虚焊不良。

苏州仁恩机电科技有限公司为客户提供集成全新半导体先进封装进口设备及材料和高端电子制造相关设备解决方案集成供应商。

业务包括：

半导体先进封装设备材料代理，电子制造进口设备代理，

培训保养维修服务及配件，融资租赁等终端集成服务